

无锡泰连芯科技有限公司

TLX875X 型

250MHz 轨至轨输出 CMOS 运算放大器

2024 年 06 月

250MHz、轨至轨输出 CMOS 运算放大器

1 特点

- 高增益带宽：250MHz
- 轨到轨输出± 1.5mV TYP V_{OS}
- 输入电压范围：-0.2V 至 +3.9V
V_S = 5V
- 电源范围：+ 2.5V 至 +5.5V
- 额定温度高达 +125°C
- 微型封装：SOT23-5

2 应用

- 音频 ADC 输入缓冲器
- 光电二极管前置放大器
- 高密度系统
- 便携式系统
- 驱动 A/D 转换器

3 描述

TLX875X 系列电压反馈 (VFB) 产品提供低电压操作、负轨输入、轨到轨输出以及出色的速度/功耗比，可提供出色的带宽 (250MHz) 和 180V/μs 的压摆率。

这些放大器为轨对轨放大器设定了业界领先的功率性能比。TLX875X 系列运算放大器在 2.5V 至 5.5V 的单电源或双电源供电下，可在 -55 °C至 +125 °C的整个温度范围内工作。

质量等级：军温级&企军标

设备信息⁽¹⁾

产品编号	封装	主体尺寸 (标称)
TLX8751	SOT23-5	2.90mm×1.60mm
TLX8752	SOP8	4.90mm×3.90mm
	MSOP8	3.00mm×3.00mm
	TSSOP8	3.00mm×4.40mm
TLX8754	SOP14	8.65mm×3.90mm
	TSSOP14	5.00mm×4.40mm

(1) 对于所有可用的封装，请参阅数据表末尾的可订购附录

目录

1 特点	2
2 应用	2
3 描述	2
4 修订历史	4
5 封装/订购信息 ⁽¹⁾	5
6 引脚配置和功能	6
7 规格	8
7.1 绝对最大额定值	8
7.2 ESD 额定值	8
7.3 建议工作条件	8
7.4 电气特性	9
7.5 典型特性	10
8 详细描述	13
8.1 概述	13
8.2 反相保护	13
8.3 EMI 抑制比 (EMIRR)	13
8.4 EMIRR IN+测试配置	14
9 申请与实施	15
9.1 应用说明	15
9.2 有源滤波器	15
10 布局	16
10.1 布局指南	16
10.2 布局示例	16
11 封装外形尺寸	17
12 卷带信息	23

4 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	更改日期	更改项目
C.1	2023/03/02	添加了卷带信息
C.2	2023/04/17	更新 7.5 典型特性中的图 12、图 13 曲线
C.3	2024/01/16	1. 更新包信息 C.2 版本第 4 页新增 MSL
C.3.1	2024/02/29	修改包装命名
C.4	2024/12/25	1. 删除 TLX8751BXF 可订购设备 2. 修改 RevC.3.1 第 1 页的描述

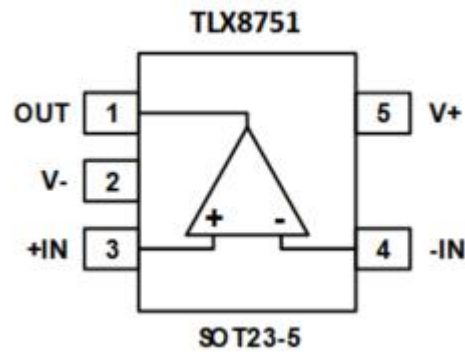
5 封装/订购信息⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	MSL	质量等级
JTLX8751XF	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	MSL1/3	企军标
JTLX8752XK	-55 °C ~+125 °C	SOP8	MSL1/3	企军标
JTLX8752XM	-55 °C ~+125 °C	MSOP8	MSL1/3	企军标
JTLX8752XQ	-55 °C ~+125 °C	TSSOP8	MSL1/3	企军标
JTLX8754XP	-55 °C ~+125 °C	SOP14	MSL1/3	企军标
JTLX8754XQ	-55 °C ~+125 °C	TSSOP14	MSL1/3	企军标
JTLX8751XF(W)	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	MSL1/3	军温级
JTLX8752XK(W)	-55 °C ~+125 °C	SOP8	MSL1/3	军温级
JTLX8752XM(W)	-55 °C ~+125 °C	MSOP8	MSL1/3	军温级
JTLX8752XQ(W)	-55 °C ~+125 °C	TSSOP8	MSL1/3	军温级
JTLX8754XP(W)	-55 °C ~+125 °C	SOP14	MSL1/3	军温级
JTLX8754XQ(W)	-55 °C ~+125 °C	TSSOP14	MSL1/3	军温级
TLX8751XF	-40 °C ~+125 °C	SOT23-5	MSL1/3	工业级
TLX8752XK	-40 °C ~+125 °C	SOP8	MSL1/3	工业级
TLX8752XM	-40 °C ~+125 °C	MSOP8	MSL1/3	工业级
TLX8752XQ	-40 °C ~+125 °C	TSSOP8	MSL1/3	工业级
TLX8754XP	-40 °C ~+125 °C	SOP14	MSL1/3	工业级
TLX8754XQ	-40 °C ~+125 °C	TSSOP14	MSL1/3	工业级

笔记:

- (1) 此信息是指定设备的最新可用数据。此数据如有更改，恕不另行通知，也不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航。
- (2) 可能还有其他标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的组装工厂中的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键或您有特殊要求，请与 TLXIC 保持一致。

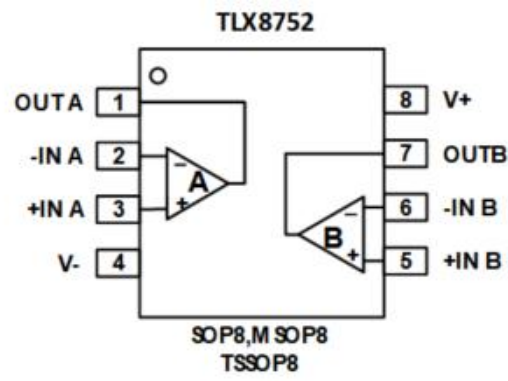
6 引脚配置和功能



引脚描述

代码	引脚	I/O ⁽¹⁾	描述
	TLX8751		
	SOT23-5		
-IN	4	I	负（反相）输入
+IN	3	I	正（同相）输入
OUT	1	O	输出
V-	2	-	负（最低）电源
V+	5	-	正极（最高）电源

(1) I = 输入，O = 输出。

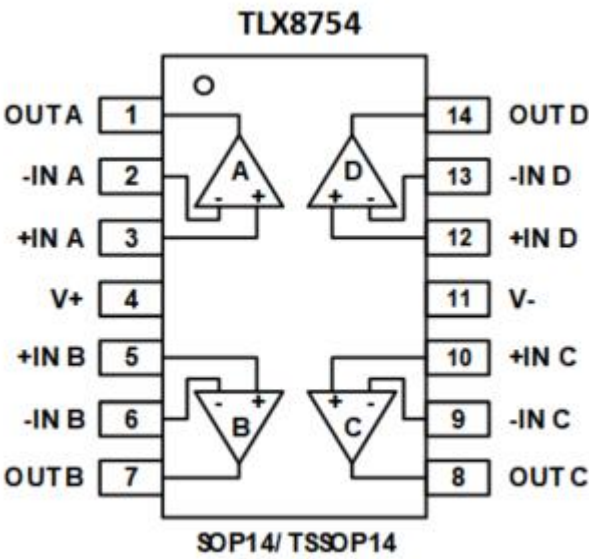


引脚描述

代码	引脚	I/O ⁽¹⁾	描述
	SOP8/MSOP8/TSSOP8		
-INA	2	I	反相输入，通道A
+INA	3	I	同相输入，通道A
-INB	6	I	反相输入，通道B
+INB	5	I	同相输入，通道B
OUTA	1	O	输出，通道 A
OUTB	7	O	输出，通道 B
V-	4	-	负（最低）电源
V+	8	-	正极（最高）电源

(1) I = 输入，O = 输出。

引脚配置和功能



引脚描述

代码	引脚	I/O ⁽¹⁾	描述
	SOP14/TSSOP14		
-INA	2	I	反相输入，通道A
+INA	3	I	同相输入，通道A
-INB	6	I	反相输入，通道B
+INB	5	I	同相输入，通道B
-INC	9	I	反相输入，通道C
+INC	10	I	同相输入，通道C
-IND	13	I	反相输入，通道D
+IND	12	I	同相输入，通道D
OUTA	1	O	输出，通道 A
OUTB	7	O	输出，通道 B
OUTC	8	O	输出，通道 C
OUTD	14	O	输出，通道 D
V-	11	-	负（最低）电源
V+	4	-	正极（最高）电源

(1) I = 输入，O = 输出。

7 规格

7.1 绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
电压	电源, $V_S = (V+) - (V-)$			7	V
	信号输入引脚 ⁽²⁾		(V-)-0.5	(V+) +0.5	
	信号输出引脚 ⁽³⁾		(V-)-0.5	(V+) +0.5	
电流	信号输入引脚 ⁽²⁾		-10	10	mA
	信号输出引脚 ⁽³⁾		-150	150	mA
	输出短路 ⁽⁴⁾		连续的		
θ_{JA}	封装热阻 ⁽⁵⁾	SOT23-5		230	°C/W
		SOP8		110	
		MSOP8		170	
		SOP14		105	
		TSSOP14		90	
		TSSOP8		240	
温度	工作范围, T_A		-55	125	°C
	交界处, $T_J^{(6)}$		-55	150	
	储存温度, T_{stg}		-65	150	

(1) 超过这些额定值的应力可能会造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大条件下可能会降低器件的可靠性。这些只是应力额定值，并不表示器件在这些或任何超出规定条件的条件下能够正常工作。

(2) 输入端通过二极管钳位到电源轨。输入信号如果超过电源轨 0.5V 以上，则应将电流限制在 10mA 或以下。

(3) 输出端通过二极管钳位到电源轨。输出信号如果能超出电源轨 0.5V 以上，则应将电流限制在 ±150mA 或以下。

(4) 短路至地，每个包装一个放大器。

(5) 封装热阻按照 JEDEC-51 计算。

(6) 最大功耗是 $T_{J(MAX)}$ 、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。所有数字适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

7.2 ESD 额定值

以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区域内处理 ESD 敏感设备。

			数值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±5000	V
		机械模型 (MM)	±400	

(1) JEDEC 文件 JEP155 指出，500 V HBM 允许采用标准 ESD 控制流程进行安全制造。



ESD 敏感度警告

ESD 损坏的范围从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化都可能导致设备不符合其公布的规格。

7.3 建议工作条件

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）

		最小值	正常值	最大值	单位
电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$	单电源	2.5		5.5	V

	双电源	± 1.25		± 2.75	
--	-----	------------	--	------------	--

7.4 电气特性

(在 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $G = +2$ 、 $R_F = 1\text{K}\Omega$ 和 $R_L = 1\text{K}\Omega$ 连接至 $V_S/2$ 、 $V_{IN_CM} = V_S/2$ 、Full⁽⁹⁾ = -55°C 至 $+125^\circ\text{C}$ ，除非另有说明。)⁽¹⁾

范围		测试条件	TLX8751、TLX8752、TLX8754			
			最小 ^{‘2’}	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
电源						
V _s	工作电压范围		2.5		5.5	V
I _Q	静态电流			2.9	3.5	mA
PSRR	电源抑制比	V _S =2.5V to 5.5V, V _{CM} =(V-)+0.5V	70	90		dB
输入						
V _{OS}	输入失调电压	V _{CM} =Vs/2	-7.5	±1.5	7.5	mV
ΔVos/ΔT	输入失调电压平均漂移	V _{CM} =Vs/2, T _A = -55°C to 125°C		±4		μV/°C
I _B	输入偏置电流 ^{(4) (5)}			±1	±10	pA
I _{OS}	输入失调电流 ⁽⁴⁾			±1	±10	pA
V _{CM}	共模电压范围	V _S = 5V	-0.2		3.9	V
CMRR	共模抑制比	V _S = 5.5V, V _{CM} =-0.2V to 3.5V	66	85		dB
输出						
V _{OS}	开环电压增益	V _S =5.0V, R _L =1KΩ, V _O =V _S -0.2V	95	110		dB
		V _S =5.0V, R _L =150Ω, V _O =V _S -0.3V	78	85		dB
ΔVos/ΔT	输出摆幅与供电轨距离	R _L =1KΩ		23		mV
I _B	输出电流源 ^{(6) (7)}			85		mA
I _{OS}	输出电流吸收器 ^{(6) (7)}			125		mA
频率响应						
	小信号带宽	V _{OUT} =100mVpp, G=1		250		MHz
		V _{OUT} =100mVpp, G=2		130		MHz
		V _{OUT} =100mVpp, G=5		33		MHz
		V _{OUT} =100mVpp, G=10		15		MHz
SR	转换速率 ⁽⁸⁾			180		V/μs
GBP	增益带宽积			250		MHz
PM	相位裕度			62		°
噪音						
e _n p-p	输入电压噪声	f = 0.1 Hz to 10 Hz		13		μVpp
e _n	输入电压噪声密度	f = 1 MHz		8		nV/√Hz

笔记:

- (1) 电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件导致设备自热非常有限。
- (2) 限值是在 25°C 下进行 100% 生产测试的。工作温度范围内的限值通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保。
- (3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间而变化，也取决于应用和配置。
- (4) 此参数由设计和/或特性确保，并未在生产中测试。
- (5) 正电流对应于流入器件的电流。
- (6) 最大功耗是 $T_J(\text{MAX})$ 、 $R_{\theta\text{JA}}$ 和 T_A 的函数。任何环境温度下的最大允许功耗为 $PD = (T_J(\text{MAX}) - T_A) / R_{\theta\text{JA}}$ 。所有数字适用于直接焊接到 PCB 上的封装。
- (7) 短路试验是瞬时试验。
- (8) 指定的数值是正向或负向斜率中较慢的一个。
- (9) 仅按特性指定。

7.5 典型特性

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

，当 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $G = +2$ 、 $R_F = 1\text{K}\Omega$ 和 $R_L = 1\text{K}\Omega$ 连接至 $V_S/2$ 时， $V_{IN,CM} = V_S/2$ 。

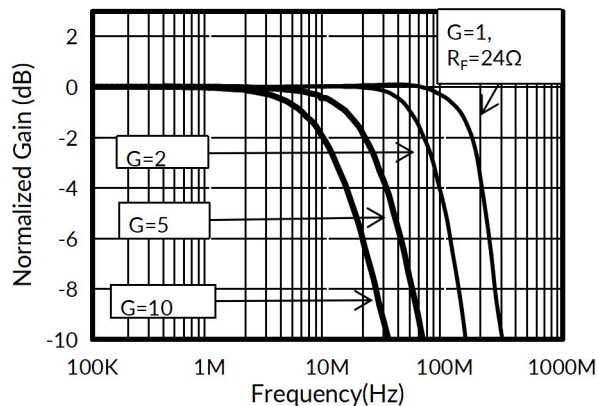


图 1. 非反相小信号频率响应

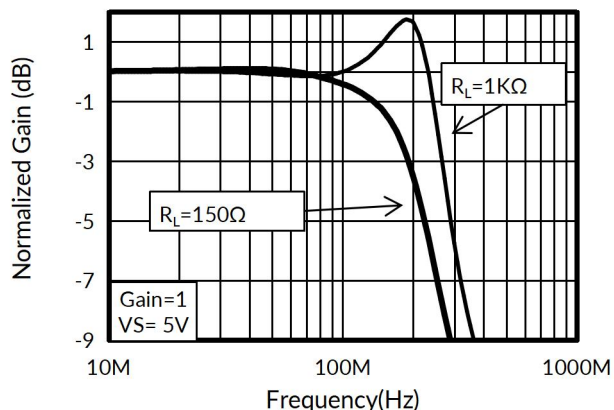


图 2. -3dB_GW

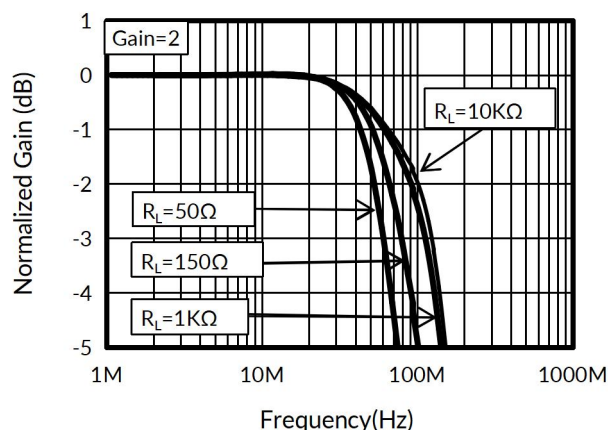


图 3. -3dB_GW

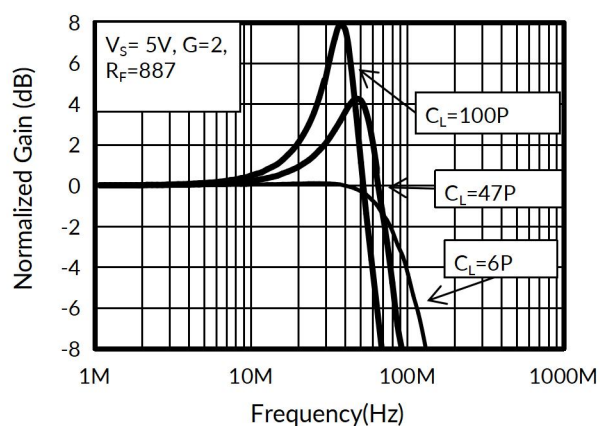


图 4. 各种 C_L 的频率响应

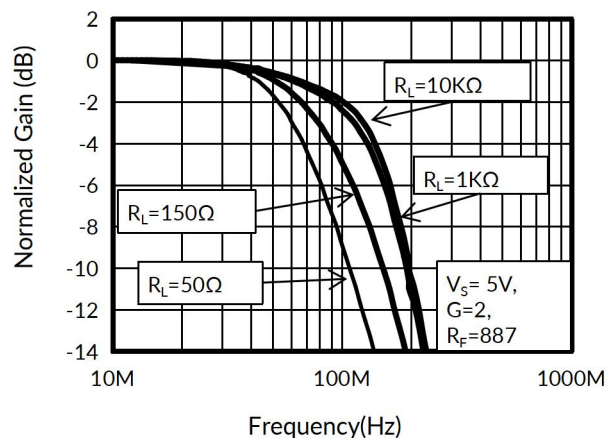


图 5. 各种 R_L 的频率响应

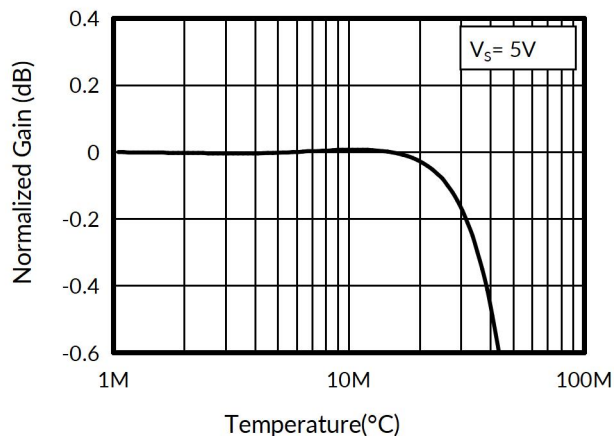


图 6. 交流响应

典型特征

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

，当 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $G = +2$ 、 $R_F = 1\text{K}\Omega$ 和 $R_L = 1\text{K}\Omega$ 连接至 $V_S/2$ 时， $V_{IN_CM} = V_S/2$ 。

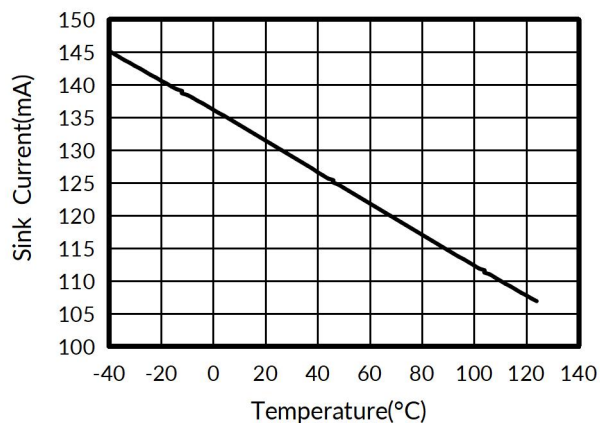


图 7. 吸收电流与温度

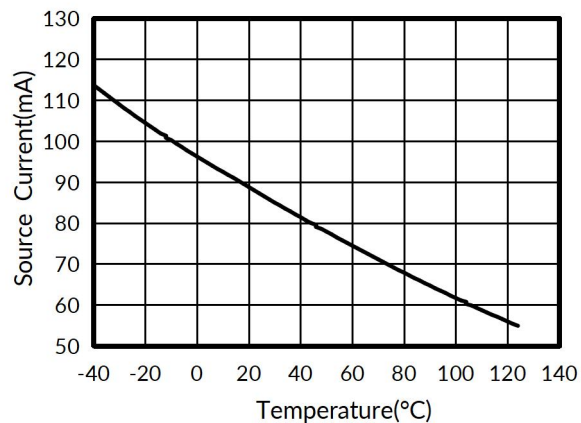


图 8. 源电流与温度

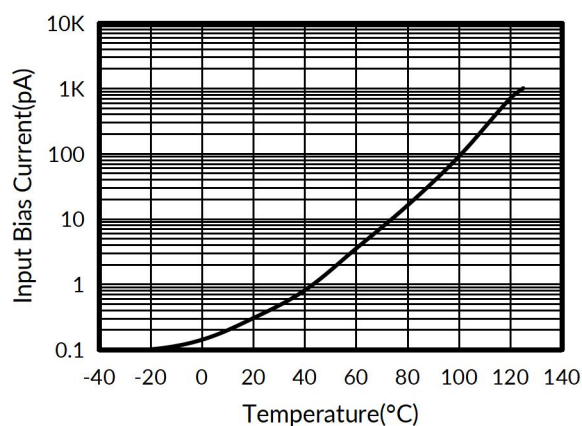


图 9. 输入偏置电流与温度

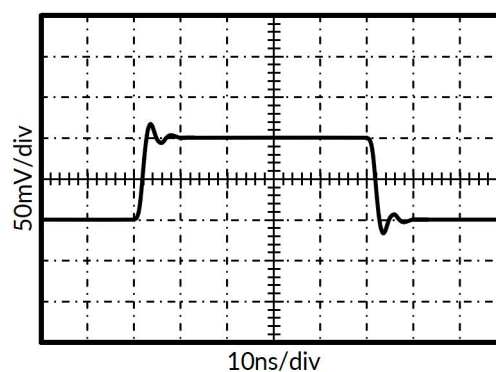


图 10. 小信号阶跃响应

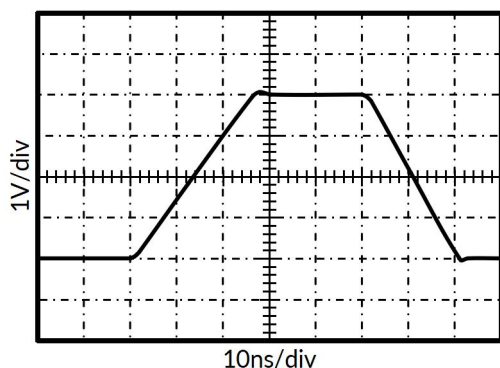


图 11. 大信号阶跃响应

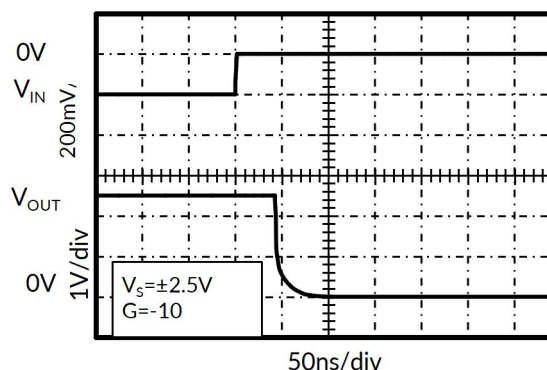


图 12. 正过载恢复

典型特征

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

，当 $T_A = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 $G = +2$ 、 $R_F = 1\text{K}\Omega$ 和 $R_L = 1\text{K}\Omega$ 连接至 $V_S/2$ 时， $V_{IN_CM} = V_S/2$ 。

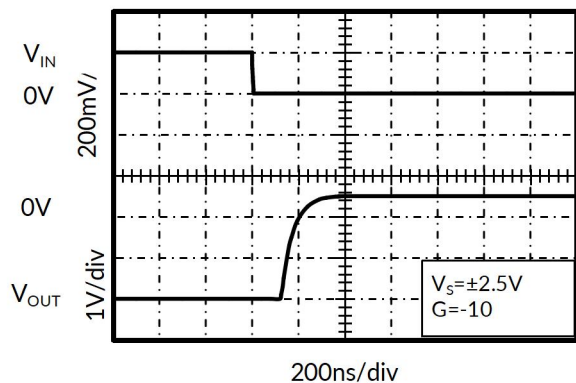


图 13. 负过载恢复

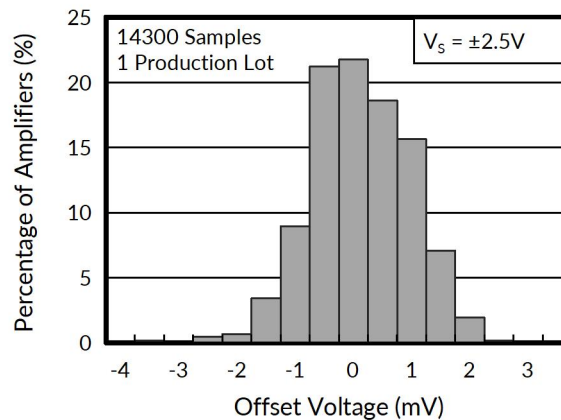


图 14. 失调电压产生分布

8 详细描述

8.1 概述

TLX875X 器件是单位增益稳定的双通道和四通道运算放大器，具有低噪声和低失真。该器件由一个低噪声输入级和一个折叠级联以及一个轨对轨输出级组成。这种拓扑结构在各种电源电压下都表现出卓越的噪声和失真性能，而这是传统商品音频运算放大器所不具备的。

8.2 反相保护

TLX875X 系列具有内部相位反转保护。当输入超出线性共模范围时，许多运算放大器都会出现相位反转。当输入超出指定的共模电压范围时，这种情况最常出现在非反相电路中，导致输出反转到相反的电压轨。TLX875X 的输入可防止因共模电压过大而导致相位反转。相反，适当的电压轨会限制输出电压。此性能如图 15 所示。

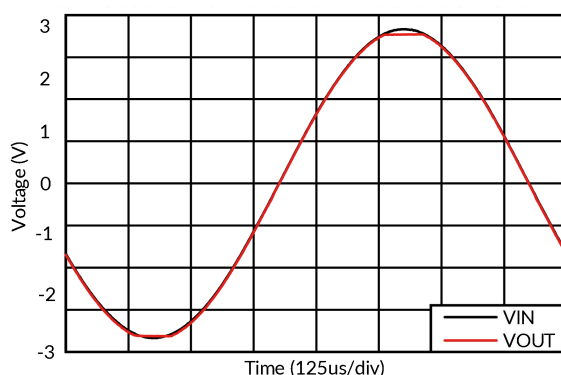


图 15. 输入过驱条件下无相位反转的输出波形

8.3 EMI 抑制比 (EMIRR)

电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 描述了运算放大器的 EMI 抗扰度。许多运算放大器都存在一个不利影响，即由于 RF 信号整流导致失调电压发生变化。能够更有效地抑制 EMI 导致的失调变化的运算放大器具有更高的 EMIRR，并以分贝值量化。EMIRR 测量可以通过多种方式进行，但本文档提供了 EMIRR IN+，它专门描述了当 RF 信号施加到运算放大器的非反相输入引脚时的 EMIRR 性能。一般来说，只测试非反相输入的 EMIRR，原因如下：

- 众所周知，运算放大器输入引脚对 EMI 最为敏感，并且通常比电源或输出引脚更好地整流 RF 信号。
- 同相和反相运算放大器输入具有对称的物理布局，并表现出几乎匹配的 EMIRR 性能。
- EMIRR 在非反相引脚上测量比其他引脚上测量更容易，因为非反相输入引脚可以在印刷电路板 (PCB) 上隔离。这种隔离允许将 RF 信号直接施加到非反相输入引脚，而无需与其他组件或连接 PCB 走线产生复杂的相互作用。

详细描述（续）

图 16 中绘制了 TLX875X 的 EMIRR IN+ 与频率的关系。如果可用，任何双路和四路运算放大器器件版本都具有大致相同的 EMIRR IN+ 性能。TLX875X 单位增益带宽为 250MHz。低于此频率的 EMIRR 性能表示干扰信号落在运算放大器带宽范围内。

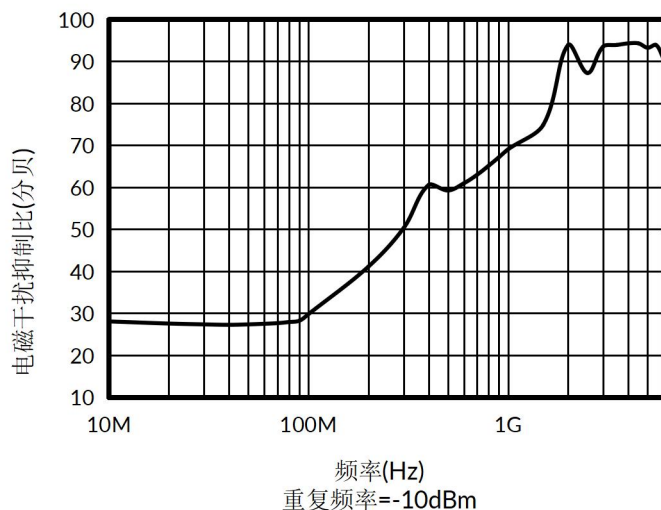


图 16. TLX875X EMIRR 与频率

8.4 EMIRR IN+测试配置

图 17 显示了用于测试 EMIRR IN+ 的电路配置。RF 源通过传输线连接到运算放大器非反相输入引脚。运算放大器配置为单位增益缓冲器拓扑，输出连接到低通滤波器 (LPF) 和数字万用表 (DMM)。运算放大器输入端的较大阻抗不匹配会导致电压反射；但是，在确定 EMIRR IN+ 时会描述并考虑这种影响。万用表对产生的直流失调电压进行采样和测量。LPF 将万用表与可能干扰万用表精度的残留 RF 信号隔离开来。

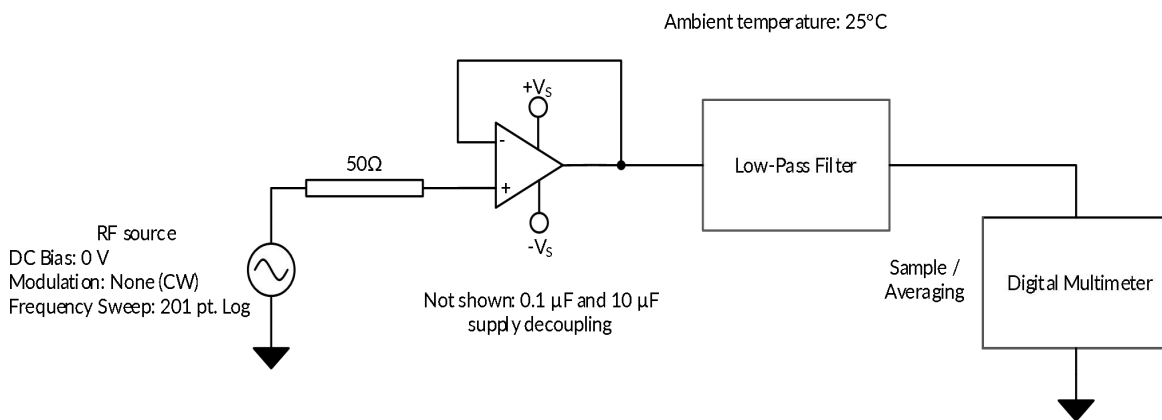


图 17. EMIRR IN+ 测试配置示意图

9 申请与实施

以下应用部分中的信息不属于 TLXIC 组件规范，TLXIC 不保证其准确性或完整性。TLXIC 的客户负责确定组件是否适合其用途。客户应验证和测试其设计实施以确认系统功能。

9.1 应用说明

TLX8751、TLX8752、TLX8754 是高精度轨到轨运算放大器，可在 2.5V 至 5.5V ($\pm 1.25\text{V}$ 至 $\pm 2.75\text{V}$) 的单电源电压下运行。高于 7V（绝对最大值）的电源电压可能会永久损坏放大器。轨到轨输出摆幅可显著增加动态范围，尤其是在低电源应用中。良好的布局实践要求使用 $0.1\mu\text{F}$ 电容器，并将其紧密放置在电源引脚上。

9.2 有源滤波器

TLX875X 系列可用于设计有源滤波器。图 18 和图 19 显示了使用 FilterPro™ 设计的 MFB 和 Sallen-Key 电路，用于实现二阶低通巴特沃斯滤波器电路。图 20 显示了频率响应。

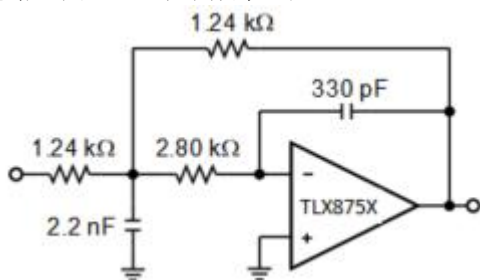


图 18. MFB 100 kHz 二阶低通巴特沃斯滤波器电路

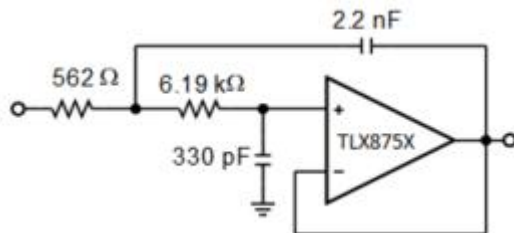


图 19. Sallen-Key 100 kHz 二阶低通巴特沃斯滤波器电路

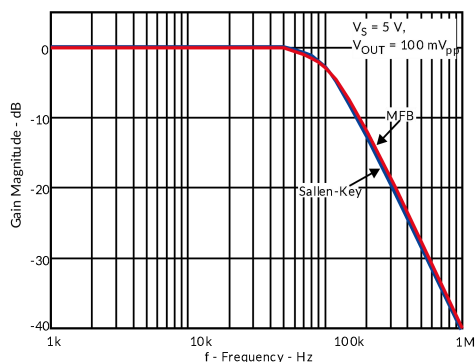


图 20. MFB 和 Sallen-Key 2nd 低通巴特沃斯滤波器响应顺序

MFB 和 Sallen-Key 滤波器电路提供类似的性能。主要区别在于 MFB 是通带中的反相放大器，而 Sallen-Key 是非反相放大器。两者的主要优点在于，单位增益的 Sallen-Key 没有电阻增益误差项，因此对增益误差不敏感，而 MFB 本身在运算放大器带宽之外具有更好的衰减特性。

10 布局

10.1 布局指南

始终建议注意良好的布局实践。保持走线短。尽可能使用 PCB 接地层，并将表面贴装元件放置在尽可能靠近设备引脚的位置。在电源引脚上放置一个 $0.1\mu\text{F}$ 电容。

这些指导原则应应用于整个模拟电路，以提高性能并提供降低 EMI 敏感性等好处。

10.2 布局示例

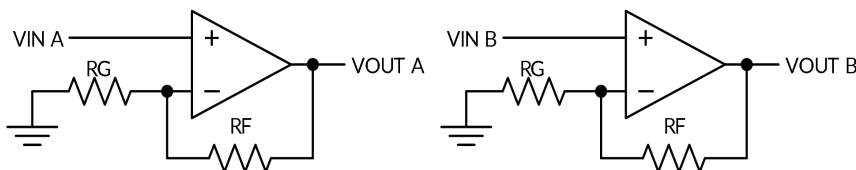


图 21. 示意图

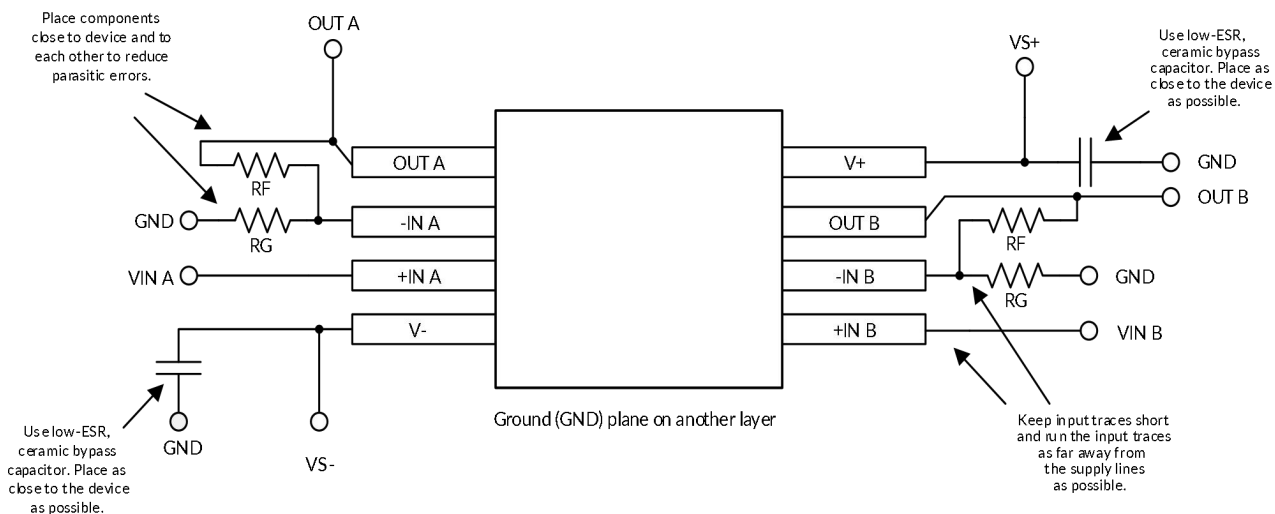
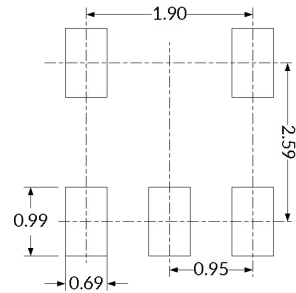
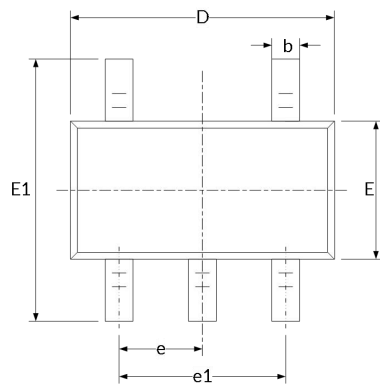


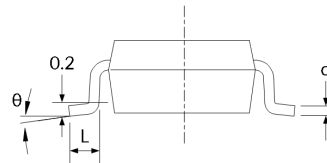
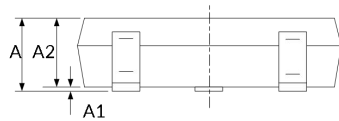
图 22. 布局示例

注意：布局建议仅针对双运算放大器，对于单运算放大器和四运算放大器请遵循类似的预防措施。

11 封装外形尺寸

SOT23-5⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

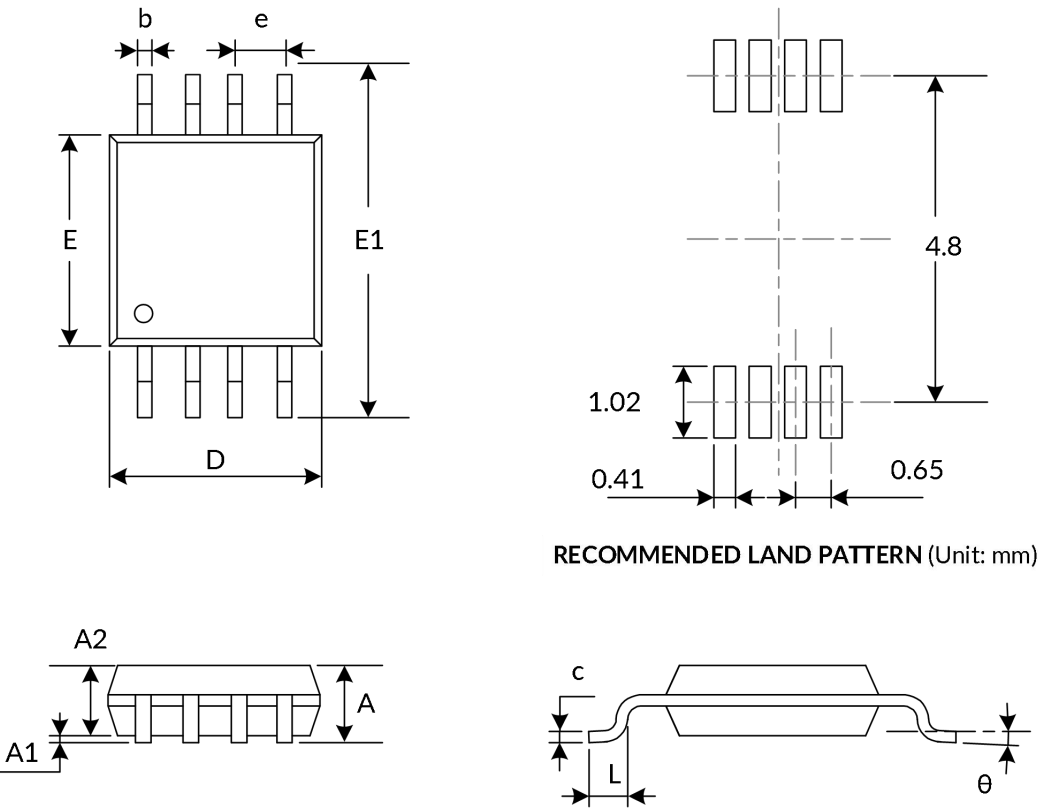


代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.820	3.020	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

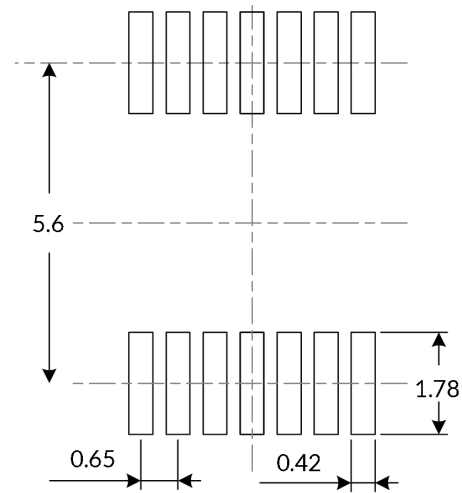
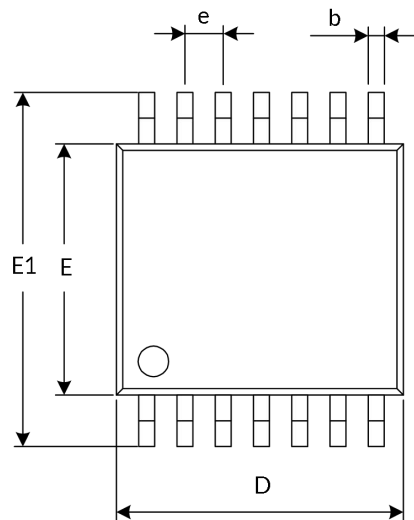
MSOP8⁽³⁾



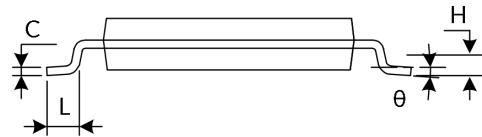
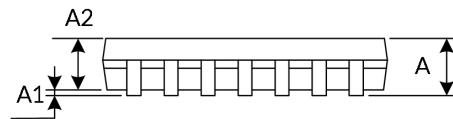
代码	尺寸（毫米）		尺寸（英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
E ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

笔记:

- 1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
- 2. BSC（中心间基本间距），“基本”间距是名义上的。
- 3. 本图纸如有变更，恕不另行通知。

TSSOP14⁽³⁾

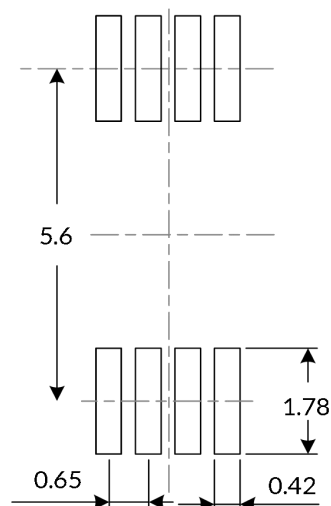
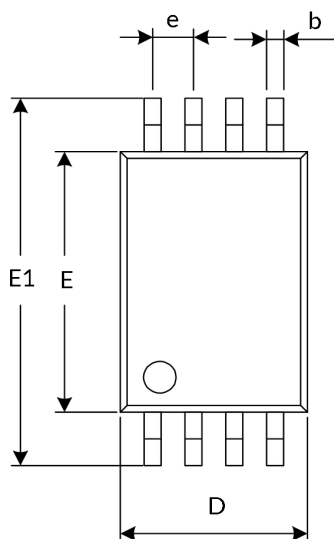
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



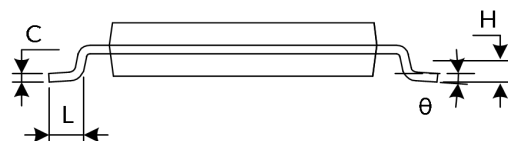
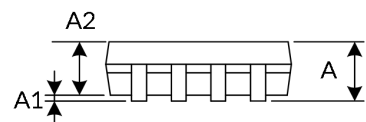
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	4.860	5.100	0.191	0.201
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25(TYP)		0.01(TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

TSSOP8⁽³⁾

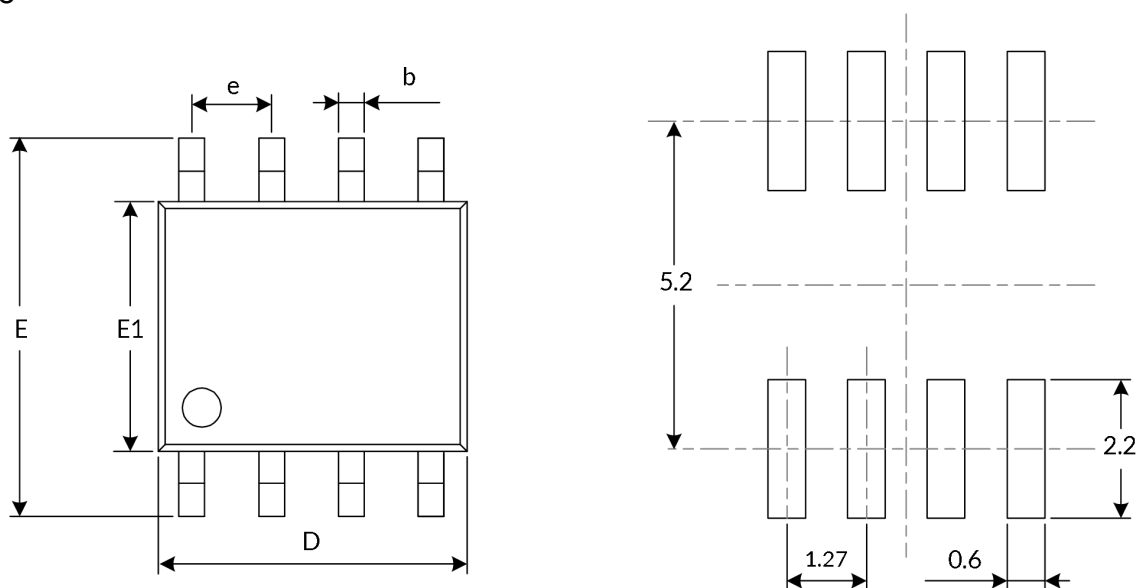
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



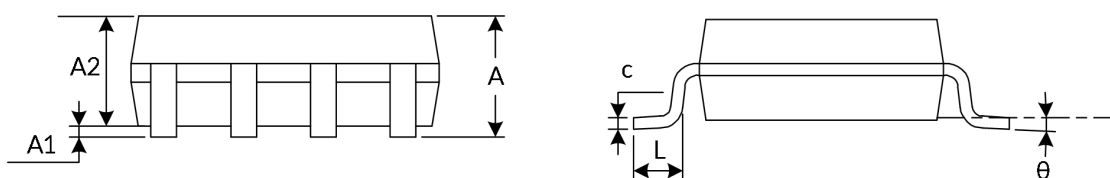
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25(TYP)		0.01(TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

SOP8 ⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

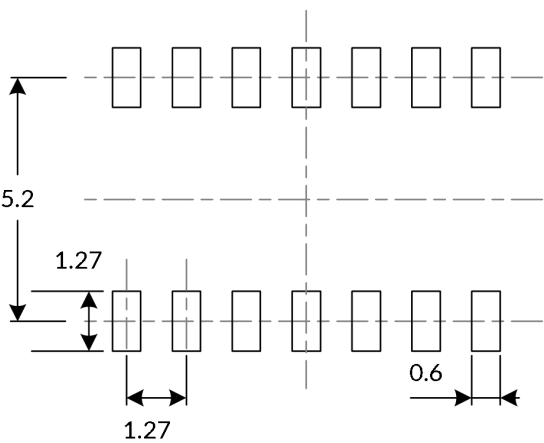
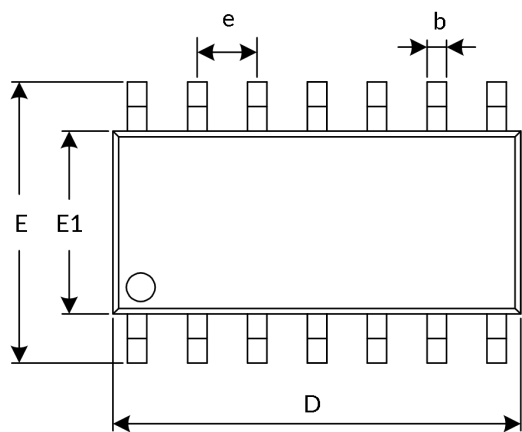


代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D ⁽¹⁾	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

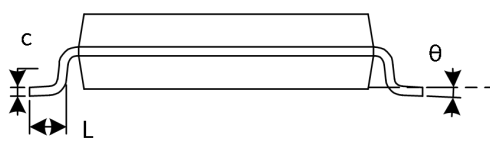
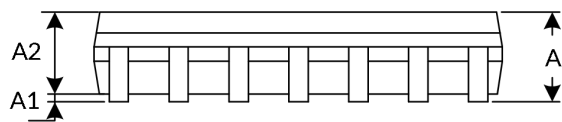
笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更, 恕不另行通知。

SOP14 ⁽³⁾



RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



代码	尺寸（毫米）		尺寸（英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.310	0.510	0.012	0.020
c	0.100	0.250	0.004	0.010
D ⁽¹⁾	8.450	8.850	0.333	0.348
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

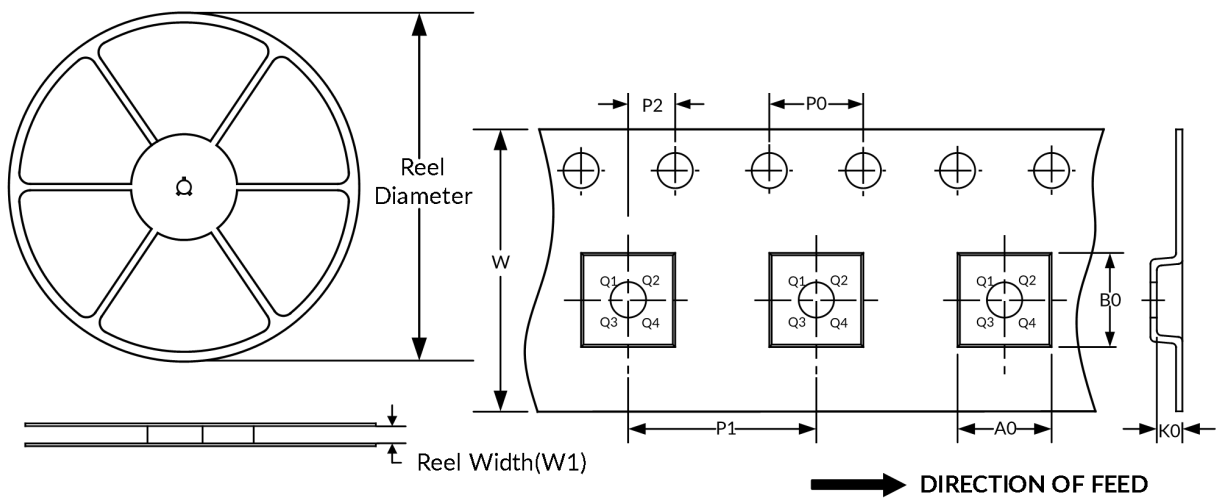
笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。
2. BSC（中心间基本间距），“基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有变更，恕不另行通知。

12 卷带信息

卷轴尺寸

胶带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带包装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷轴宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
MSOP8	13"	12.4	5.20	3.30	1.50	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
TSSOP14	13"	12.4	6.95	5.60	1.20	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
SOP8	13"	12.4	6.40	5.40	2.10	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
SOP14	13"	16.4	6.60	9.30	2.10	4.0	8.0	2.0	16.0	Q1
TSSOP8	13"	12.4	6.90	3.45	1.65	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

笔记：

- 1. 所有尺寸均为标称尺寸。
- 2. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。